

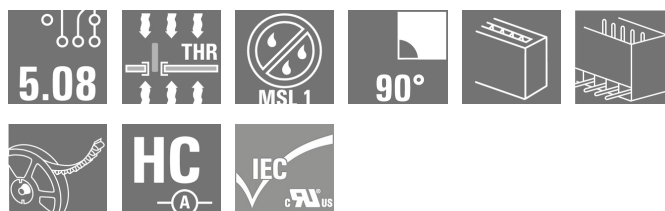
SL-SMT 5.08HC/05/180G 1.5AU BK RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Connecteur mâle résistant aux températures élevées, avec conditionnement en boîte ou en rouleau. En rouleau, avec picot à souder 1,5 mm, optimisé pour l'implantation automatique. Longueurs de picots de 3,2 mm indiquées pour les applications de soudure à la vague et par refusion. Les connecteurs mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés. HC = Courant fort.

Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT/THR, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 90°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, Au (Or), noir, Tape
Référence	2595570000
Type	SL-SMT 5.08HC/05/180G 1.5AU BK RL
GTIN (EAN)	4050118608007
Qté.	250 pièce(s)
Indices de produit	IEC: 400 V / 27.5 A UL: 300 V

Emballage

Tape

Date de création 7 novembre 2022 13:53:19 CET

SL-SMT 5.08HC/05/180G 1.5AU BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	12 mm	Profondeur (pouces)	0,472 inch
Hauteur	9,9 mm	Hauteur (pouces)	0,39 inch
Hauteur version la plus basse	12 mm	Largeur	27,3 mm
Largeur (pouces)	1,075 inch	Poids net	3,773 g

Classifications

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ECLASS 9.0	27-44-04-02
ECLASS 9.1	27-44-04-02	ECLASS 10.0	27-44-04-02
ECLASS 11.0	27-46-02-01	ECLASS 12.0	27-46-02-01

Caractéristiques du système

Famille de produits	OMNIMATE Signal - série BL/SL 5.08	Type de raccordement	Raccordement sur platine
Montage sur le circuit imprimé	Raccordement soudé THT/THR	Pas en mm (P)	5,08 mm
Pas en pouces (P)	0,2 inch	Angle de sortie	90°
Nombre de pôles	5	Nombre de picots par pôle	1
Longueur du picot à souder (l)	1,5 mm	Tolérance sur la longueur du picot à souder	0 / -0,3 mm
Dimensions du picot à souder	d = 1,2 mm, octogonal	L1 en mm	20,32 mm
L1 en pouce	0,8 inch	Nombre de rangs	1
Nombre de pôles	1	Degré de protection	IP20
Résistance de passage	≤5 mΩ	Cycles d'enchâssage	≥ 100
Force d'enchâssage/pôle, max.	9 N	Force d'extraction/pôle, max.	7 N

Données des matériaux

Matériau isolant	LCP GF	Couleur	noir
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Groupe de matériaux isolants	IIIa
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	≥ 175	Tenue d'isolation	≥ 10 ⁸ Ω
Moisture Level (MSL)	1	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau des contacts	CuMg	Surface du contact	Au (Or)
Structure en couches du raccordement soudé	1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn mat	Structure en couches du contact mâle	1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn mat
Température de stockage, min.	-40 °C	Température de stockage, max.	70 °C
Température de fonctionnement, min.	-50 °C	Température de fonctionnement, max.	100 °C
Plage de température montage, min.	-30 °C	Plage de température montage, max.	100 °C

Données nominales selon CEI

testé selon la norme	IEC 60664-1, IEC 61984	Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)	27,5 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)	19 A	Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C)	24 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C)	16,5 A	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2	400 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2	320 V	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2	4 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2	4 kV		

SL-SMT 5.08HC/05/180G 1.5AU BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Données nominales selon CSA

Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)	300 V	Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA)	18,5 A
---	-------	--	--------

Données nominales selon UL 1059

Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)	300 V
---	-------

Emballage

Emballage	Tape	Longueur VPE	0 m
Largeur VPE	0 m	Hauteur VPE	0 m
Profondeur ruban (T2)	17,45 mm	Largeur du ruban (W)	44 mm
Profondeur du ruban (K0)	16,95 mm	Hauteur ruban (A0)	8 mm
Largeur du ruban (B0)	28,9 mm	Séparation ruban (P1)	16 mm
Orifice de séparation ruban (E)	1,75 mm	Séparation ruban (F)	20,2 mm
Diamètre de bobine du ruban ϕ (A)	330 mm	Résistance de la surface	$R_s = 10^9 - 10^{12} \Omega$
Largeur pastille Pick & Place (W_{PPP})	9,6 mm	Longueur pastille Pick & Place (L_{PPP})	12,36 mm
Diamètre de la surface de retrait (ϕD_{max})	8,5 mm	Épaisseur saillie pastille 1 Pick & Place ($L_{01} (PPP)$)	2,3 mm
Épaisseur saillie pastille 2 Pick & Place ($P_{02} (PPP)$)	2 mm		

Note importante

Conformité IPC	Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
Remarques	• Surfaces de contact dorées sur demande • Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles. • Diamètre du trou d'implantation $D = 1,4 \pm 0,1$ mm • Diamètre du trou d'implantation $D = 1,5 \pm 0,1$ mm à partir de 9 pôles • Sur le schéma, P = pas • Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables. • Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité moyenne de 70 %, 36 mois

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	CB Certificate CB Testreport
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Livre blanc technologie de montage en surface	Download Whitepaper

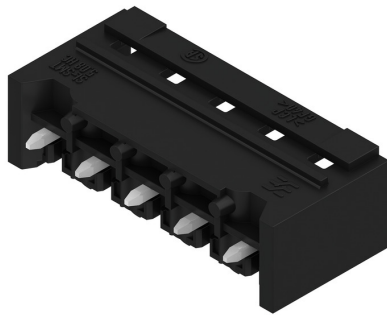
SL-SMT 5.08HC/05/180G 1.5AU BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

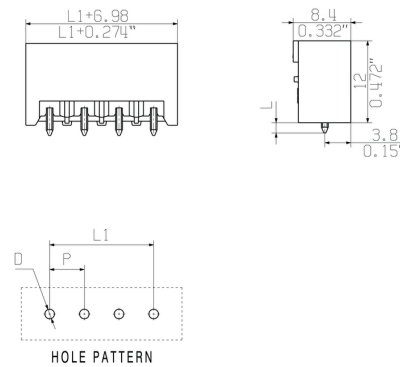
www.weidmueller.com

Dessins

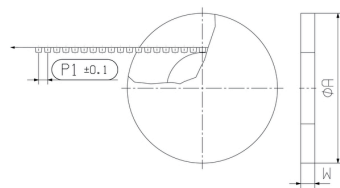
Illustration du produit



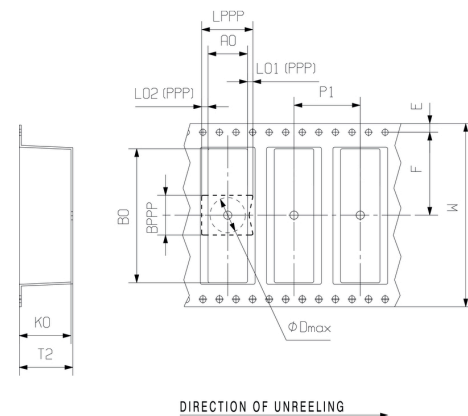
Dimensional drawing



Dimensional drawing



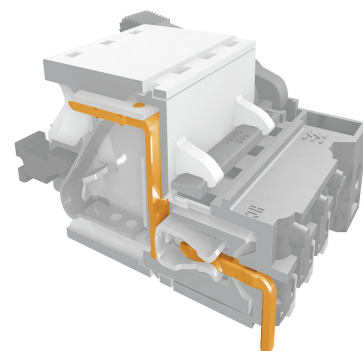
Dimensional drawing



Exemple d'utilisation



Avantages produit

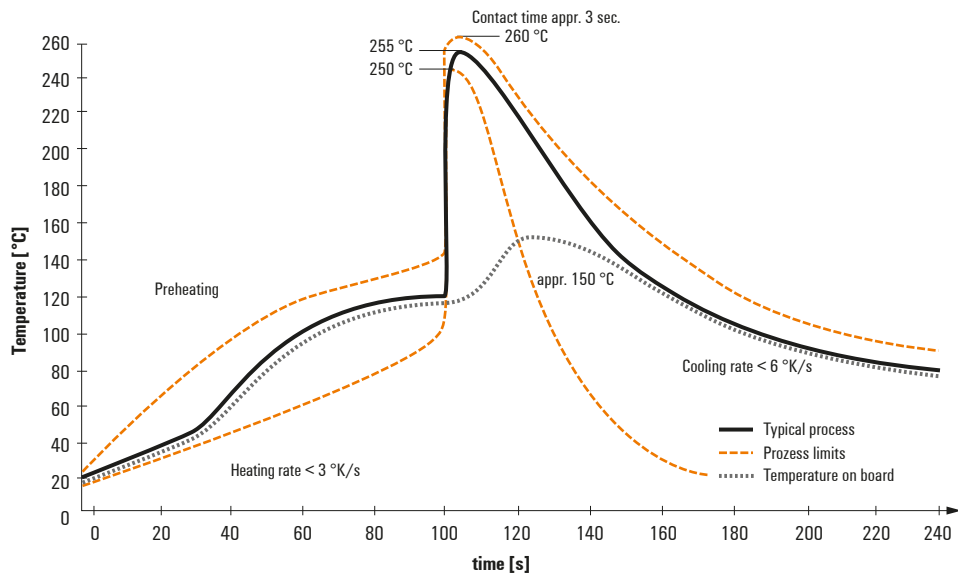


Safe power transmission
Proven properties

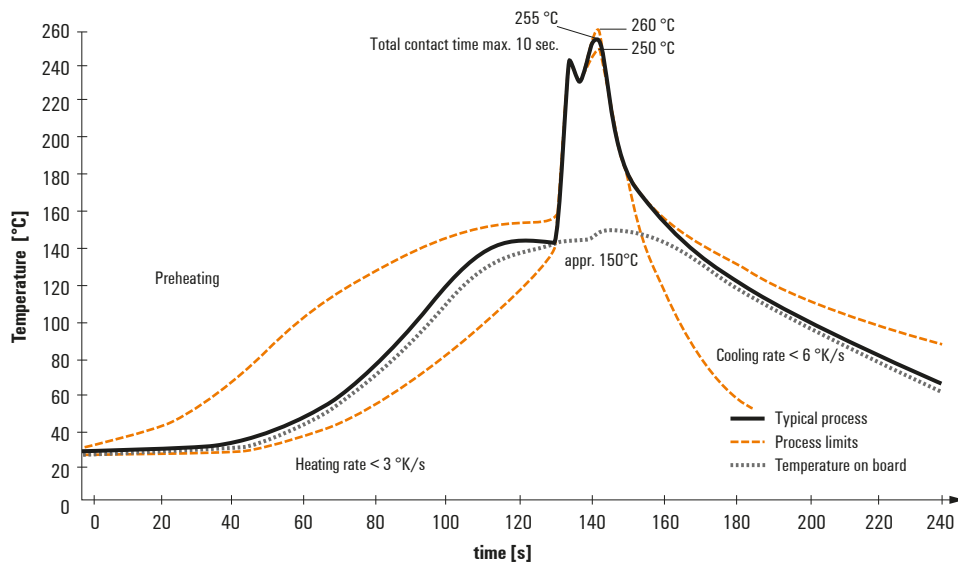
Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

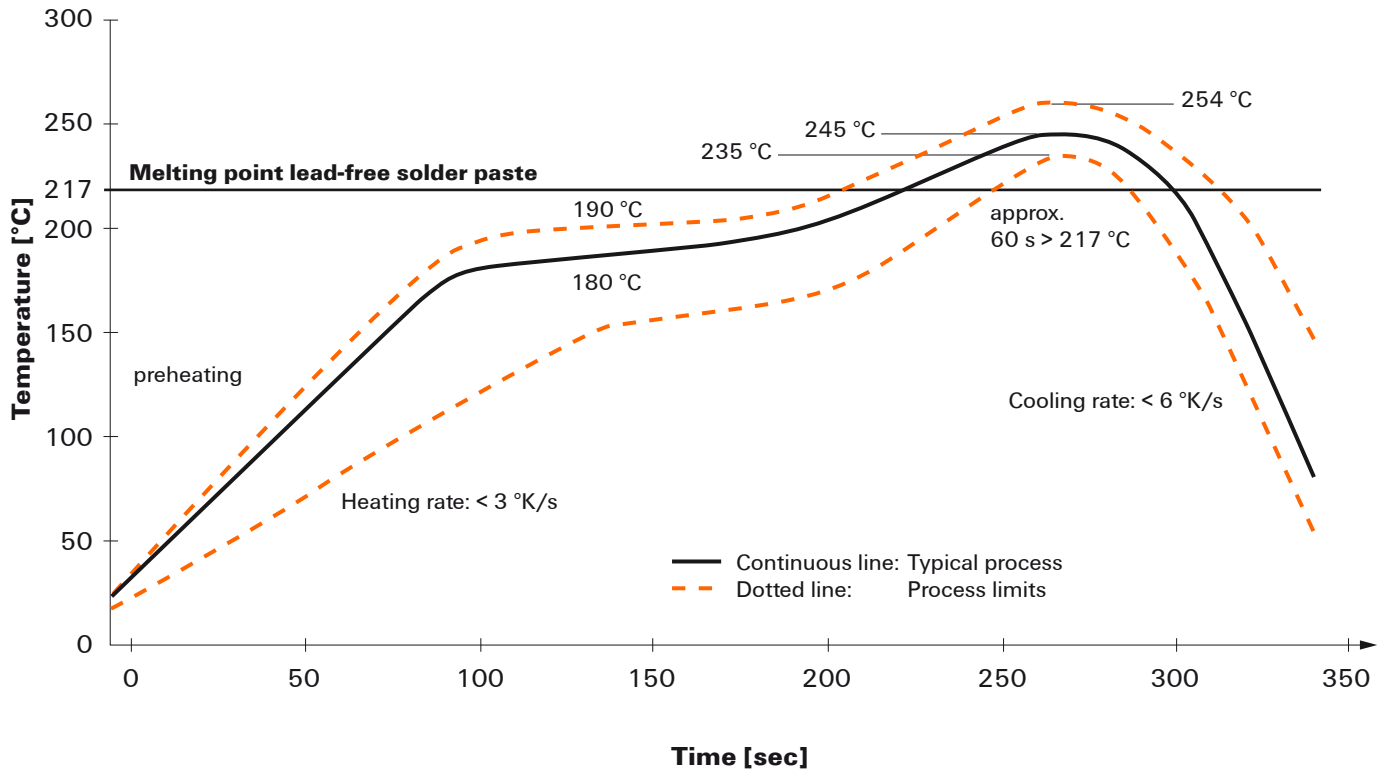
- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.